

仕 様 書

1. 件名

空気ばね式除振台

2. 研究の概要

国立研究開発法人産業技術総合研究所分析計測標準研究部門及びサイバーフィジカルセキュリティ研究センター(以下、「産総研」という。)では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合研究開発機構(NEDO)受託「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として、半導体デバイスにおける非破壊的なイメージングの開発研究を実施している。

3. 装置の概要

本装置は、半導体デバイスへの情報通信に係る侵入・耐性試験のために必要な光学イメージング技術の開発および半導体のX線検査が可能となるように、半導体チップをマイクロスケールでチップ化できるレーザー加工システムを構築するための光学定盤である。

4. 装置の基本構成

- ・空気ばね式除振台

5. 基本構成別仕様

- ・空気ばね式除振台

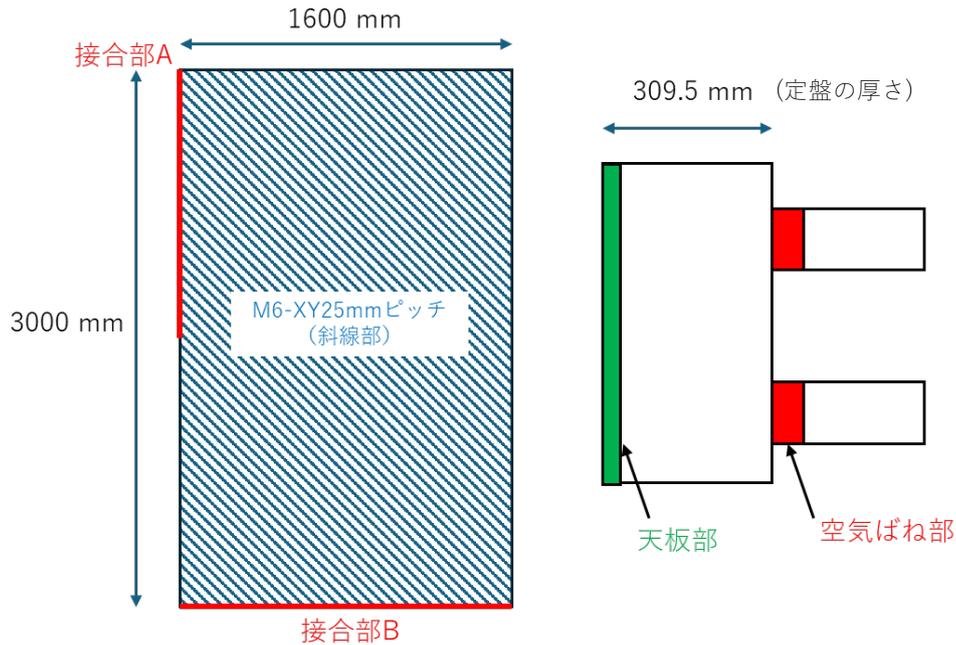
- (1) 除振台は 3000mm×1600mm×700mm の寸法であること。
- (2) 除振台上部の定盤はスチールハニカム構造であること。
- (3) 除振台上部の定盤は 3000mm×1600mm かつ厚さは 309.5mm の寸法であること。
- (4) 定盤部の天板は 25mm ピッチで M6 ネジの加工がされていること。
- (5) 定盤部の天板は非磁性ステンレス SUS304 であること。
- (6) 定盤部の天板は厚み 5mm であること。
- (7) 定盤の側面 2 箇所(図 1: 接合部 A・B)に接合部を有すること。
- (8) 接合部 A は長さ 1500mm の区間につき M16 ネジを上下にて締結する構造を有すること。
- (9) 接合部 A で産総研所有の「空気ばね式除振台 I (AS-2715TJS-304)」と段差なく確実にジョイントできること。
- (10) 接合部 B は一面につき M16 ネジを上下で締結する構造であること。
- (11) 接合部 B で産総研所有の「空気ばね式除振台 II (TDIS-1516LA(Y))」と確実にジョイントできること。

イントできること。

(12) 接合部 A・B でのジョイント部を比較して接合部 A とのジョイントがより高精度でジョイントできることを保証すること。

(13) 定盤は空気バネで浮遊しており、脚部構造は地震に強い溶接によるフレーム一体構造及び、地震対策として定盤部が脚部より分離しない構造を有すること。

図 1: 三次元空気ばね式除振台のレイアウト



6. 特記事項

なし

7. 納品確認試験

本装置を搬入、据付、調整の後、調達請求者の立会いのもと、仕様書を満たしていることを確認したうえで、装置が正常に作動することを確認し、その結果を納品確認試験成績書として提出すること。

8. 納入物品

- | | |
|---------------|------------------|
| (1) 空気ばね式除振台 | 1 台 |
| (2) 取扱説明書 | 1 部 (紙媒体または電子媒体) |
| (3) 構成品一覧表 | 1 部 (紙媒体または電子媒体) |
| (4) 納品確認試験成績書 | 1 部 (紙媒体または電子媒体) |

※電子媒体で提出する場合、USB メモリ等の外部電磁記録媒体を用いないこと。

9. 納入の完了

本装置は、「8. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

10. 納入期限及び納入場所

納入期限：2025年10月31日

納入場所：茨城県つくば市梅園 1-1-1

国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター中央事業所 2 群
分析計測標準研究部門 2-1D 棟 D01115 室

11. 付帯事項

- (1) 本装置は、据付調整の後、当所担当者の立ち会いのもとに仕様書を満たしていることの確認を行い、納入の完了とする。
- (2) 納入時には、本装置の安全操作及び一般的な保守について講習を行うこと。
- (3) 納入された製品における能力内の使用中に発生した納入の完了後1年以内の故障については、その修理、調整等責任をもって無償で行うこと。
- (4) 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。
- (5) 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。